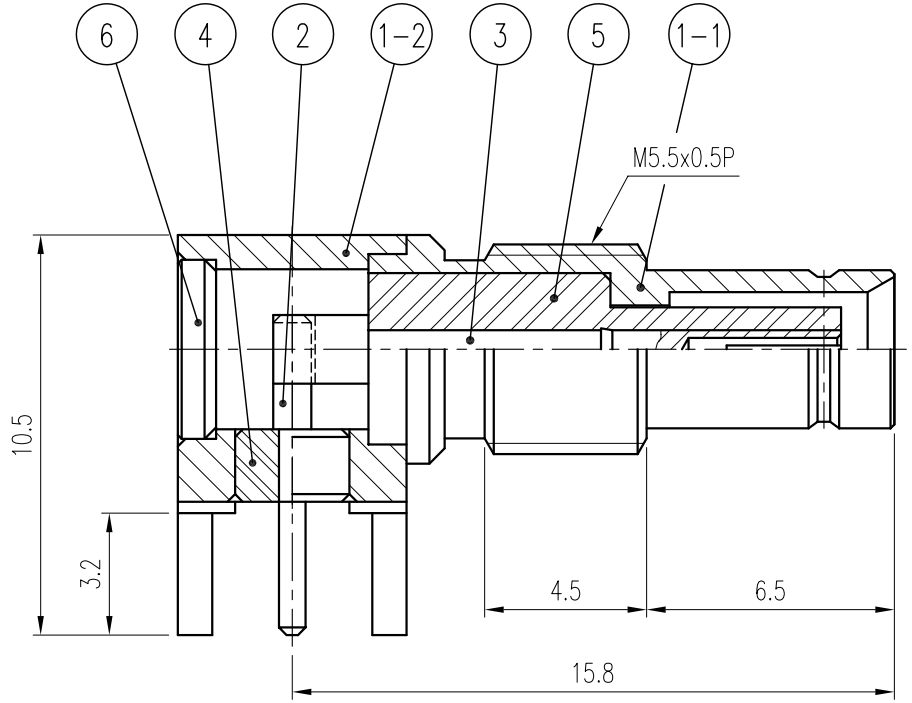
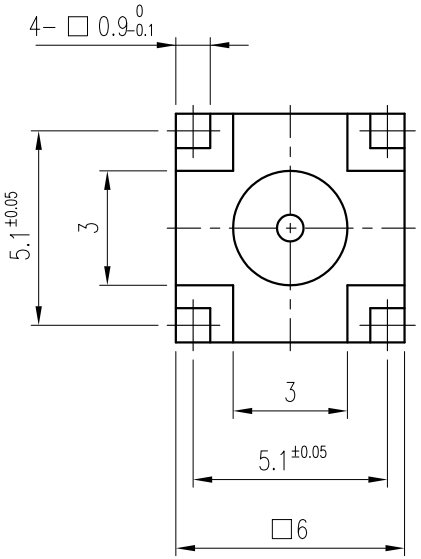
ST \ 가공									
ST(기존)									
ST(개선)									

수 정 내 용				
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일





품번		품 명	수량	재 질	표면처리	비 고	
6		COVER	1	MBsBD	Gold Plate	DCO00022-5/1 (LB002)	
5		INSULATOR	1	TEFLON		DIN00825-N/1 (H5510)	
4		INSULATOR	1	TEFLON		DIN00822-N/1 (H5505)	
3		CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00877-5/1 (E5509)	
2		CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00875-5/1 (E5507)	
1	1-2	BODY (B)	1	MBsBD	Gold Plate	DBB00259-5/1	DBD01086-3/1
	1-1	BODY (A)	1	MBsBD	Gold Plate		DBD01088-3/1

대체가능재질

공통공차
.* ±0.1
.** ±0.05

재질 _____

열처리 _____

보호피막처리 _____

년월일 2000. 2. 24.

승인

검도

제도

작성부서 연 구 소

척도 6/1 단위 mm 중량 ___

KJ COMTECH
KJ COMTECH CO.,LTD.

RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명 이소텍 상사
DIN-1.0/2.3-J-LB

A4

도번 CN00598-7/1

K319-621-000